

2026年应用数学、建模与智能计算国际学术会议

2026 International Conference on Applied Mathematics, Modelling and

Intelligent Computing (CAMMIC 2026)

2026年3月27-29日 中国上海

会议通知

尊敬的各位参会学者、研究员与单位：

2026年应用数学、建模与智能计算国际学术会议（CAMMIC 2026）将于2026年3月27-29日在中国上海召开。会议将围绕“应用数学、建模与仿真、智能计算”的最新研究领域，为来自国内外高等院校、科学研究所、企事业单位的专家、教授、学者、工程师等提供一个分享专业经验，扩大专业网络，面对面交流新思想以及展示研究成果的国际平台，探讨本领域发展所面临的关键性挑战问题和研究方向，以期推动该领域理论、技术在高校和企业的发展和应用。大会诚邀国内外高校、科研机构专家、学者，企业界人士及其他相关人员投稿及参会交流！

一、组织单位

【主办单位】上海大学

【承办单位】上海大学理学院数学系

【技术支持】ACM SIGAI

二、会议组委

大会主席

王健教授，中国石油大学（华东），中国

唐遠炎教授，澳门大学，中国，IEEE Life Fellow

Judith Gal-Ezer教授，以色列开放大学，以色列，ACM Fellow

组织委员会主席

朱佩成教授，上海大学，中国

技术委员会主席

詹志辉教授，南开大学，中国，IEEE Fellow、AAIA Fellow

朱海滨教授，尼普森大学，加拿大，IEEE Fellow

于坤杰教授，郑州大学，中国

出版主席

张大军教授，上海大学，中国

Neil Gordon教授，赫尔大学，英国

2026年应用数学、建模与智能计算国际学术会议

2026 International Conference on Applied Mathematics, Modelling and Intelligent Computing (CAMMIC 2026)

2026年3月27-29日 中国上海

ZAILAN BIN SIRI副教授，马来亚大学，马来西亚

Paul Pang副教授，联邦大学，澳大利亚

三、论文出版

所有的投稿经过2-3位组委会专家审稿后，最终录用稿件将由ACM ICPS(979-8-4007-2329-2)出版，见刊后提交至EI Compendex、Scopus检索，往届会议皆已完成检索。

四、会议主题

Track 1: 数据智能与知识发现

Track 2: 机器学习与智能算法

Track 3: 建模、仿真与预测分析

Track 4: 计算科学与数值技术

Track 5: 智能系统与交叉应用

Track 6: 可视化、交互与前沿集成技术

(详情请见会议官网)

五、参会方式

1、全文投稿并参会：一篇录用文章包含一名作者免费参会做报告；

2、口头报告：申请口头报告，时间为10-15分钟，中英文皆可；

3、海报展示：需提供一份A1竖版尺寸、JPG或PNG格式的彩色电子版的海报；

4、听众参会：仅参会听会，可提问交流。

六、投稿报名链接

全文投稿链接：<https://www.ais.cn/attendees/paperSubmit/AQR2YA?invite=CPSHU>

参会报名链接：<https://www.ais.cn/attendees/toSignUp/AQR2YA?invite=CPSHU>

模板下载链接：<https://www.cammic.org/download>

*投稿时请务必填写组织单位专属邀请码“CPSHU”，享主办方投稿优惠。

*投稿前可联系大会秘书，获取论文模板、投稿注意事项或海报模板等必要信息。

2026年应用数学、建模与智能计算国际学术会议

2026 International Conference on Applied Mathematics, Modelling and
Intelligent Computing (CAMMIC 2026)

2026年3月27-29日 中国上海

七、会议日程

2026年3月27日 大会签到

2026年3月28日 大会主题报告&口头报告

2026年3月29日 学术考察

八、联系方式

会议官网: www.cammic.org

会务组: 卜老师 手机/微信: +86- 17760758061

上海大学理学院数学系

2026 年 1 月 27 日